

Profil for kabelinnføringen, bak

for TS, CM, TP

Det er annerledes enn ved profilen for kabelinnføringen, midt på blir den bakre profilen stukket direkte på bunnåpningen. Dermed kan ved montering av montasjeplaten i bakerste montasjestilling (TS) eller ved CM-en kablene føres direkte på en kabeloppsamlingsskinne uten større bøyeradiuser. I kombinasjon med kabelfangskinne kan det opprettes en optimal tilpasning mellom kabelinnføring og montasjeplate.

Materiale:

- Aluminiumsprofil
- Pakning: PU-skum
- Tverrsnitt: 30 x 25 mm

Kapslingsklasse:

IP 55 ved riktig montering.

For skapbredde mm	Pk.	Best.nr. TS
600	1 sett	8802.065
800	1 sett	8802.085
1000	2 sett	8802.105
1200	2 sett	8802.125
1600	2 sett	8802.165

Henvisning:

1 sett er nok for en bunnåpning opptil skapbredde 800 mm. Fra skapbredde 1000 mm er to bunnåpninger tilgjengelig. 2 sett per skap kan monteres.



Tilbehør:

Kabelfangskinne, se side 717.



Elastisk klemprofil

For tetting av kabelinnføringen mellom bunnplattene. Spesielt egnet for like kabeltverrsnitt.

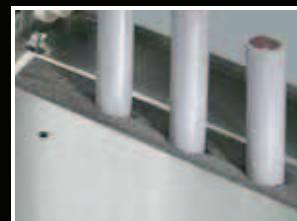
Materiale:

- PU-skum
- Tverrsnitt: 30 x 30 mm

Kapslingsklasse:

IP 55 ved riktig montering.

Pk.	Best.nr. SZ
3 m	2573.000



EMC-bunnplater

se side 687.

